



Taiwan Polyimide

We know Polyimide

法說會報告資料

Kevin Chen/Janifer Huang/Paul S. C. Wu

Nov. 07, 2024

CONFIDENTIAL

免責聲明

本簡報係由達邁科技股份有限公司(以下簡稱本公司)提供，本簡報可能包含前瞻性陳述，當中涉及風險與不明朗因素包括陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：經營上的改變、競爭環境、經濟情勢、法規變化、科技發展與超出本公司管控等因素，皆可能導致本公司實際營運結果與上開前瞻性陳述有很大的差異。本公司不承擔因情勢變更而即時更新或修正相關內容之義務。

本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約，邀約之引誘或建議。本公司已盡合理之注意，使本簡報於公開時無任何不真實或誤導。本公司及其各關係企業代表人或董事，均不對此使用或因他人引用本份簡報資料、或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

公司簡介

2024年Q1~Q3營運暨應用市場概況

公司發展策略 & 布局未來

問題與交流

公司簡介

報告者:陳岱村副總經理

Company Profile 簡介



Polyimide Film
Manufacturer



- Established: June, 2000
- Company capital: ~42M USD
- Plant sites: Hsinpu & Tongluo
- Employees: ~385
- IPO in TSE: October, 2011

2024年Q1~Q3營運情形

報告者:陳岱村副總經理

綜合損益表



單位：新台幣佰萬元

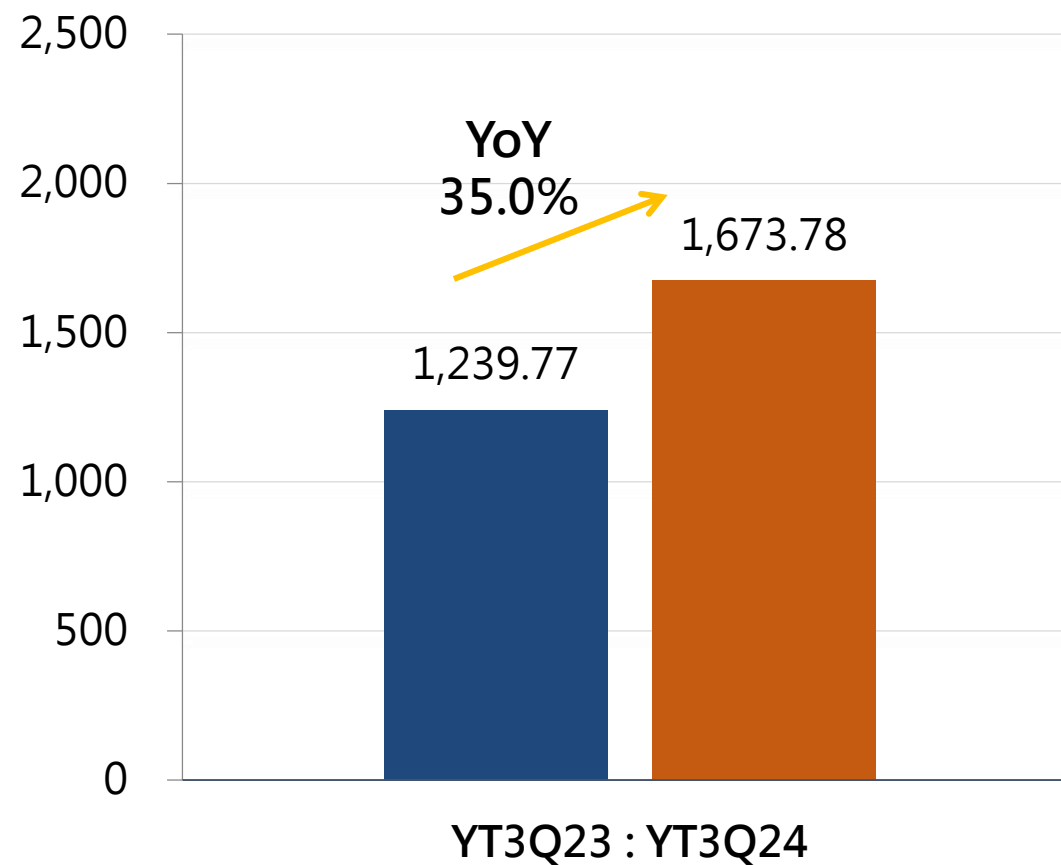
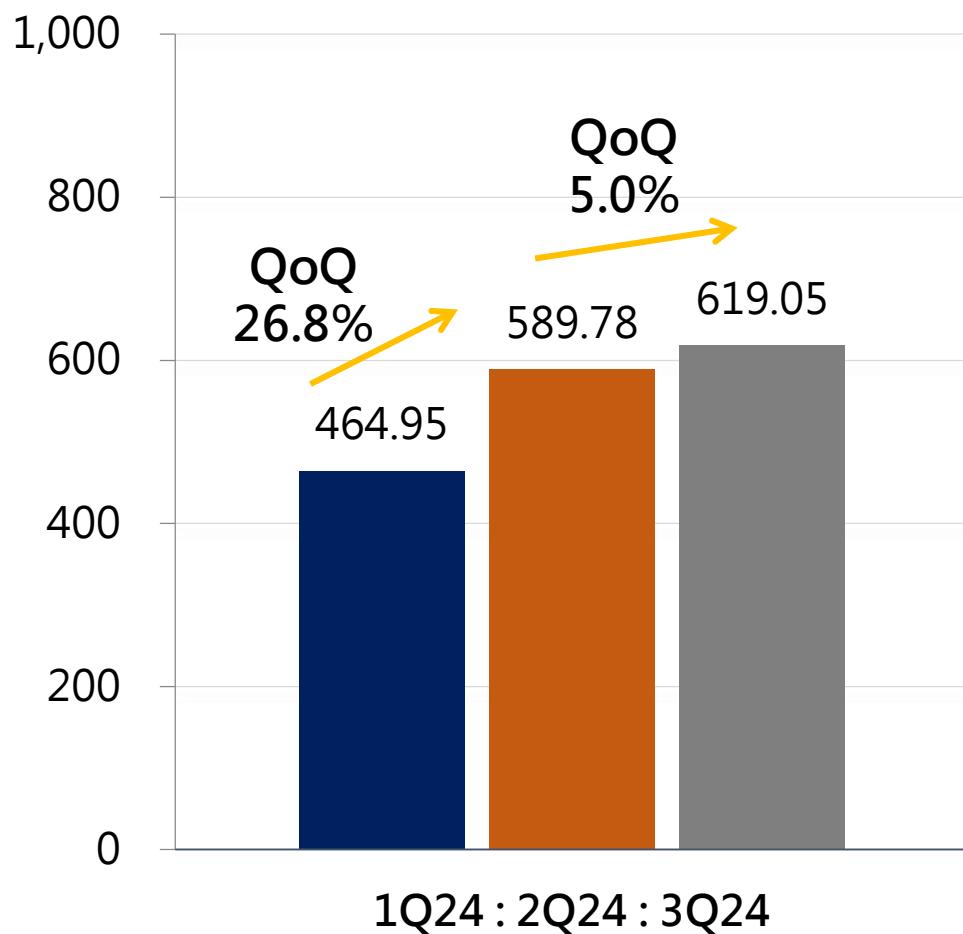
綜合損益表項目	3Q24	2Q24	1Q24	YT3Q24	YT3Q23	季變化	年變化
營業收入淨額	619.05	589.78	464.95	1,673.78	1,239.77	5.0%	35.0%
營業毛利率	30.1%	31.0%	21.8%	28.1%	17.6%	-0.9ppts	10.5ppts
營業費用	124.10	89.28	77.13	290.51	272.66	39.0%	6.5%
營業利益(損)	62.03	93.65	24.27	179.95	(55.03)	-33.8%	427.0%
營業淨利率	10.0%	15.9%	5.2%	10.8%	-4.4%	-5.9ppts	15.2ppts
營業外收入及支出	(0.25)	21.47	3.53	24.74	(1.68)	-101.2%	1572.6%
稅前淨利(損)	61.78	115.12	27.80	204.69	(56.71)	-46.3%	460.9%
所得稅費用	0.54	(1.46)	3.07	2.13	9.82	137.0%	-78.3%
合併本期淨利(損)	61.24	116.58	24.73	202.56	(66.53)	-47.5%	404.5%
純益率	9.9%	19.8%	5.3%	12.1%	-5.4%	-9.9ppts	17.5ppts
每股盈餘(虧損)(新台幣元)	0.49	0.91	0.22	1.61	(0.43)	-46.2%	474.4%

*2024年第三季加權平均流通在外股數為132佰萬股

合併營業收入



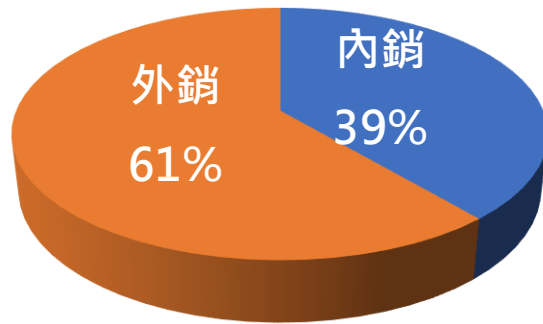
單位：新台幣佰萬元



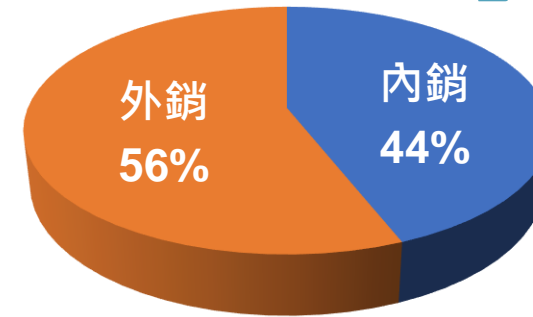
銷售市場



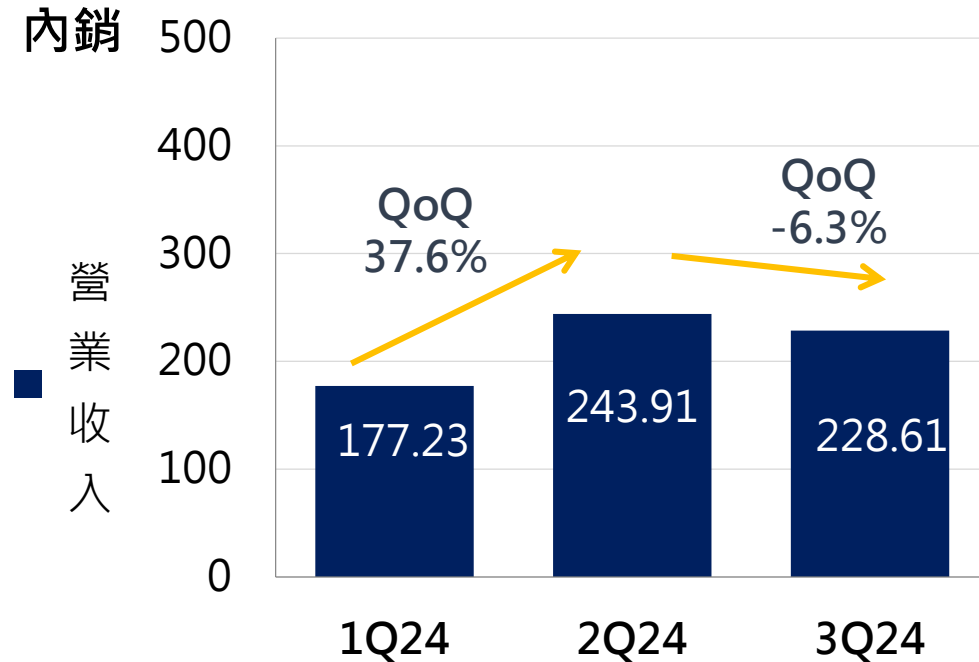
2024年Q1~Q3



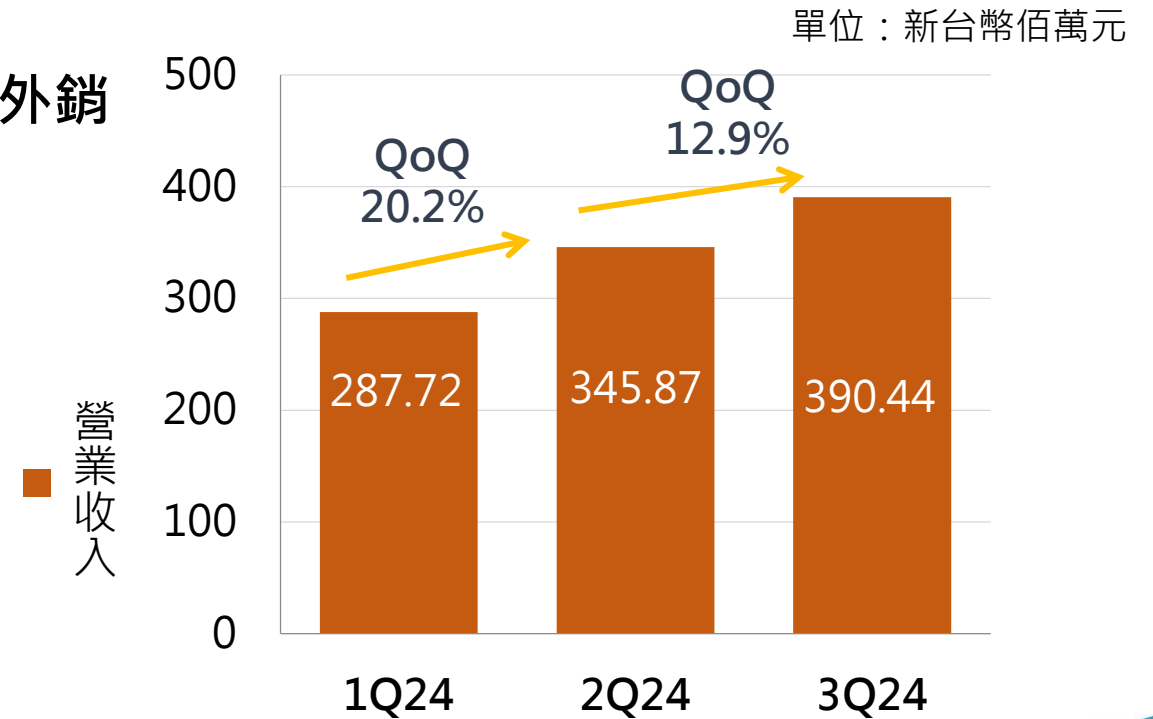
2023年Q1~Q3



內銷

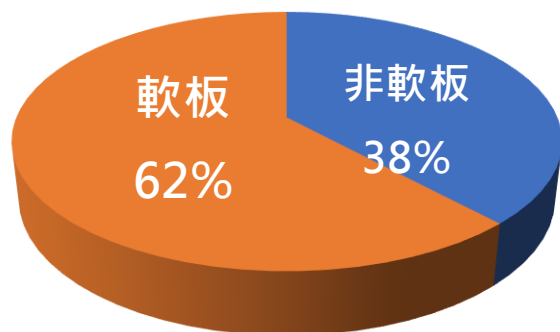


外銷

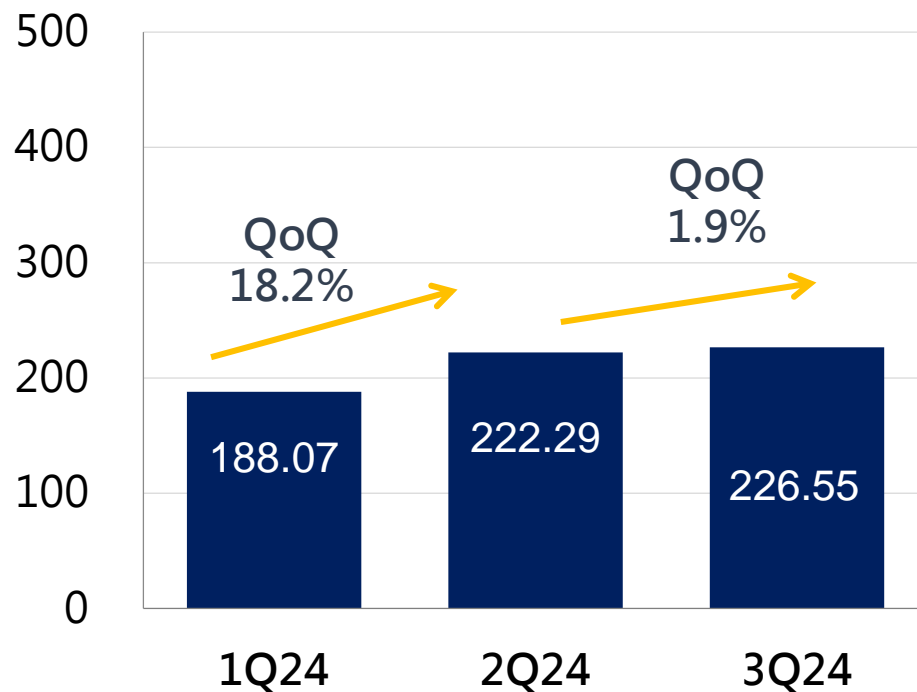


應用市場

2024年Q1~Q3

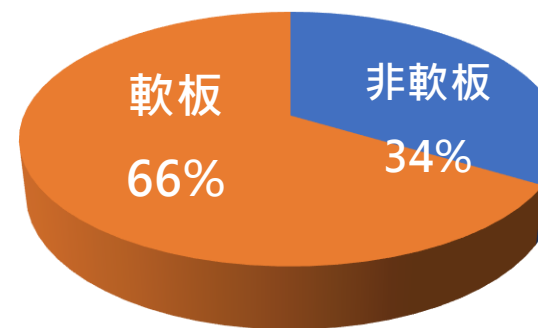


非軟板



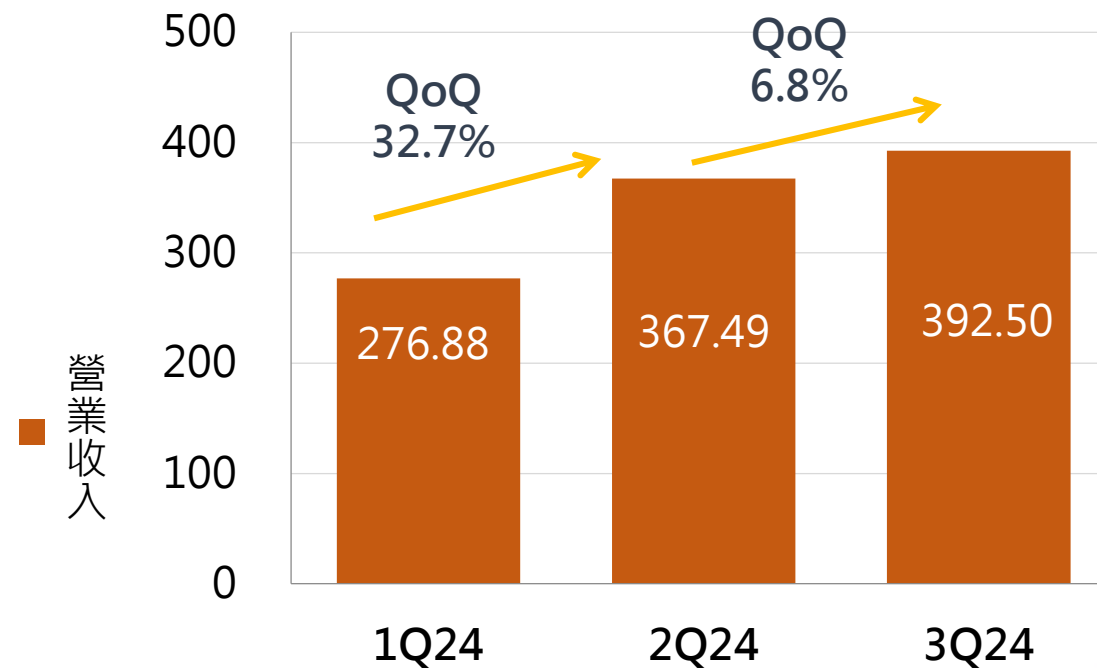
2023年Q1~Q3

TAIMIDE



單位：新台幣佰萬元

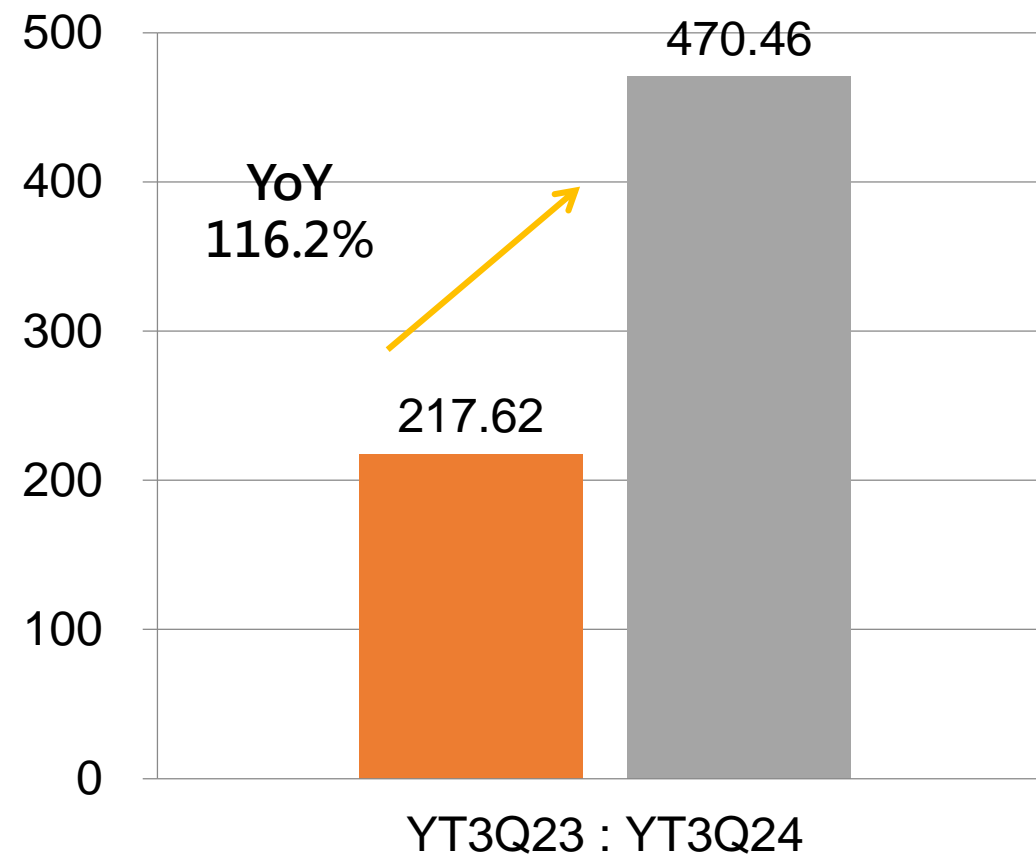
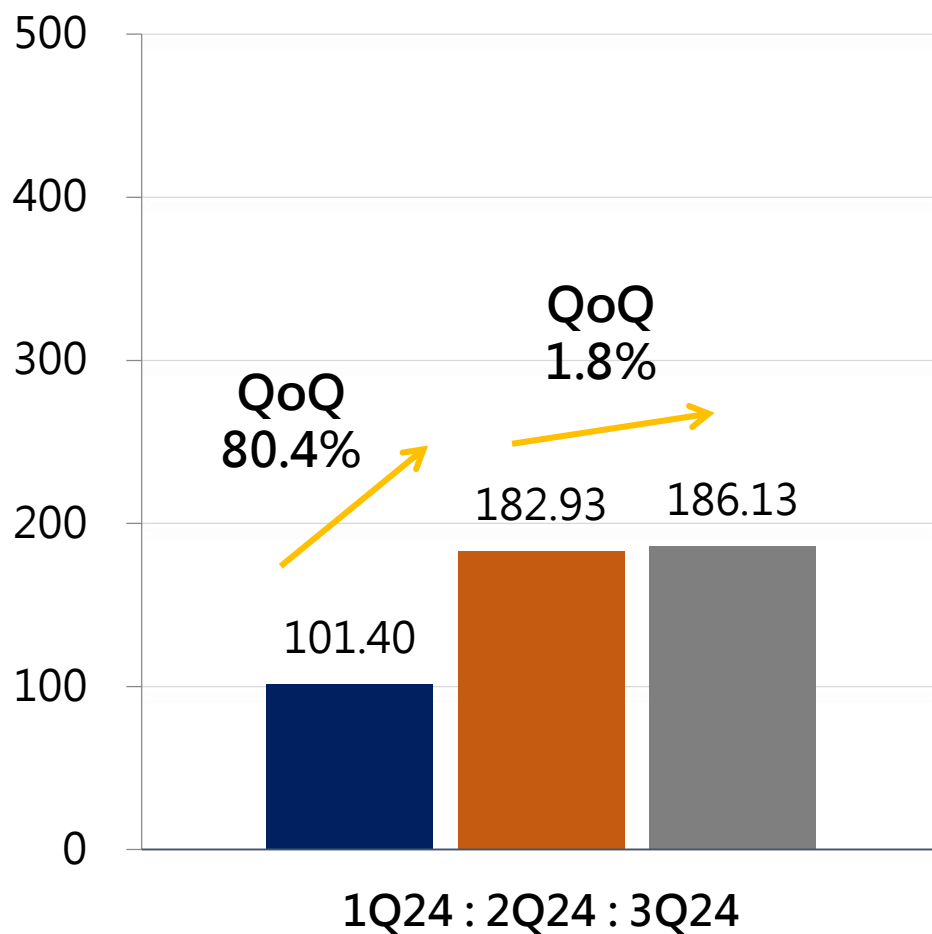
軟板



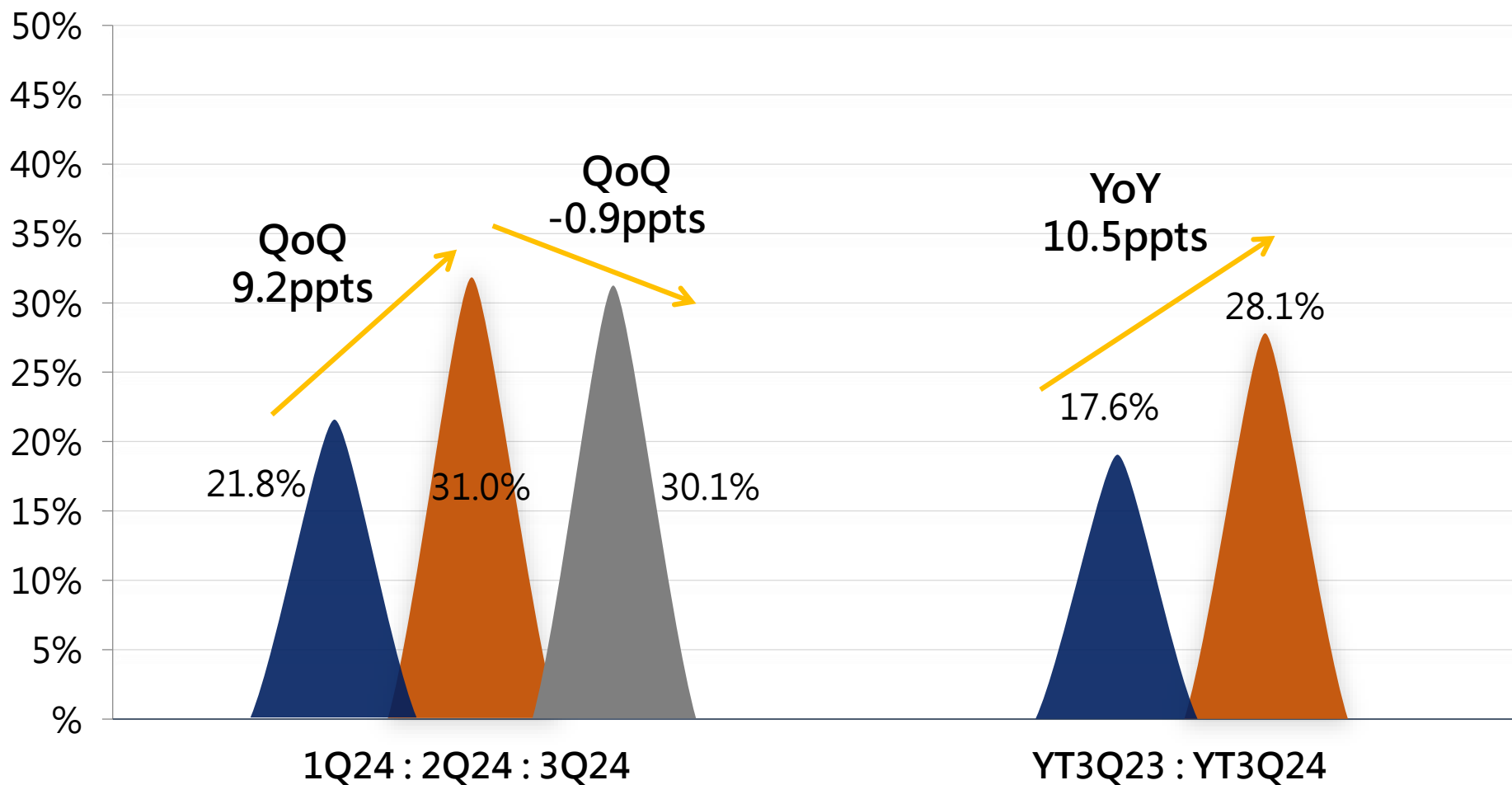
合併營業毛利



單位：新台幣佰萬元

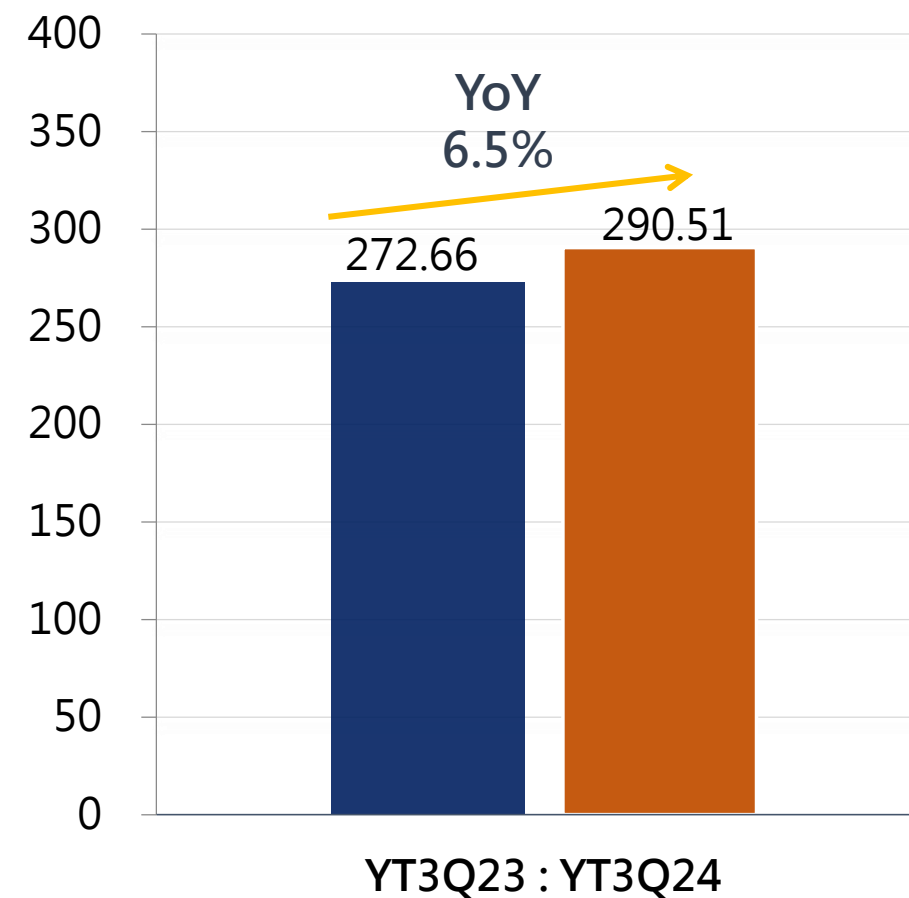
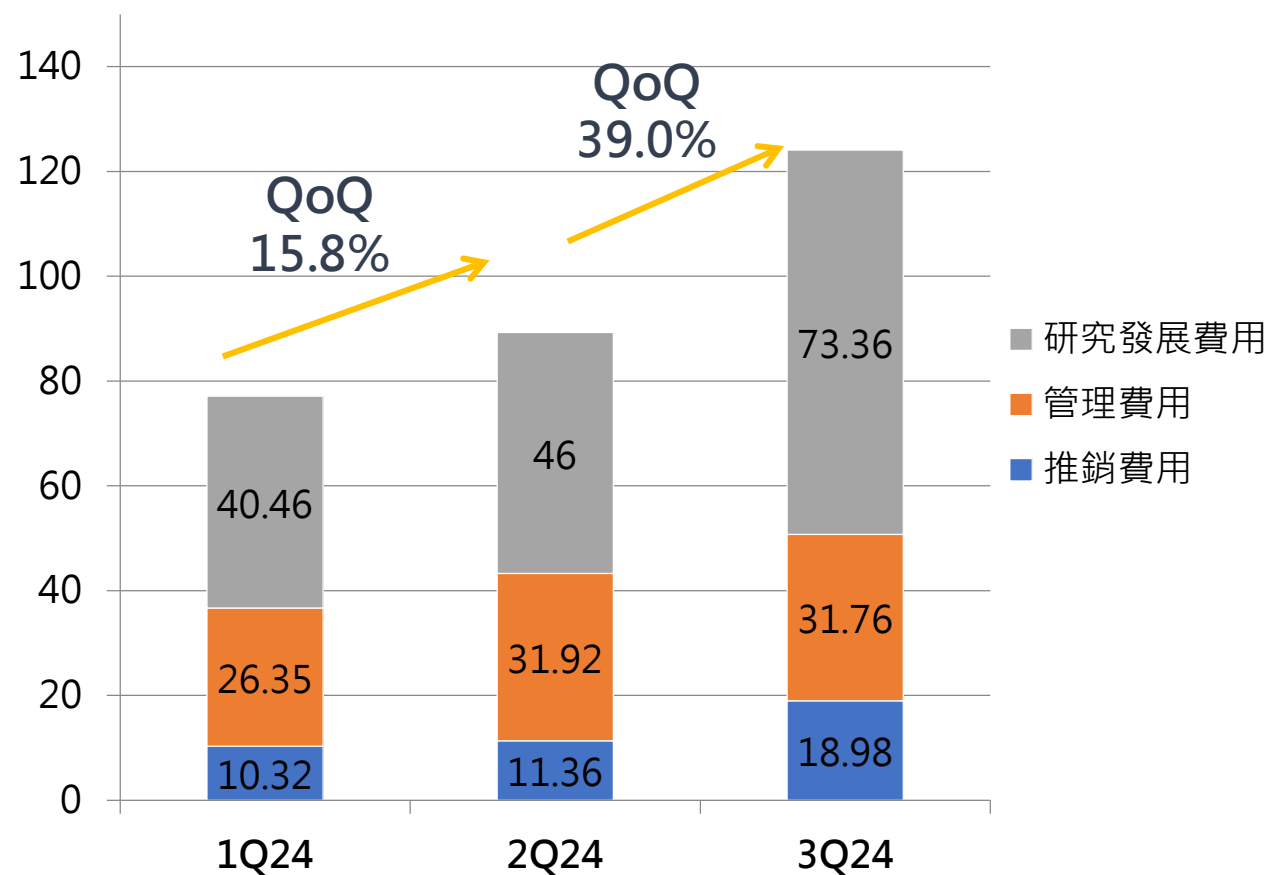


合併營業毛利率



合併營業費用

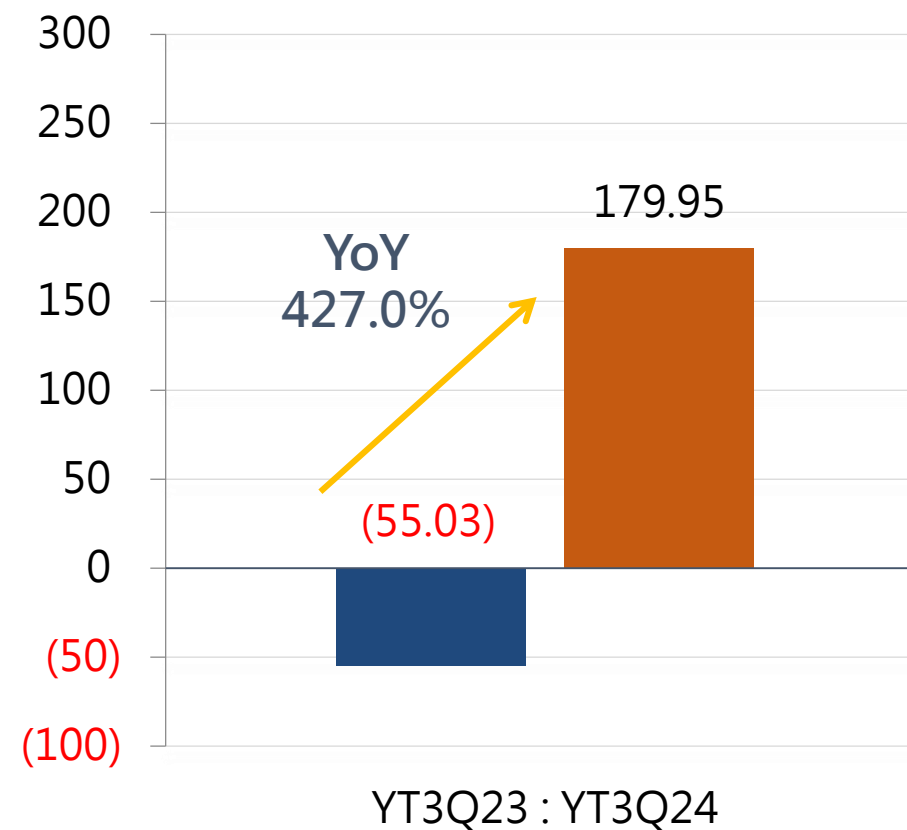
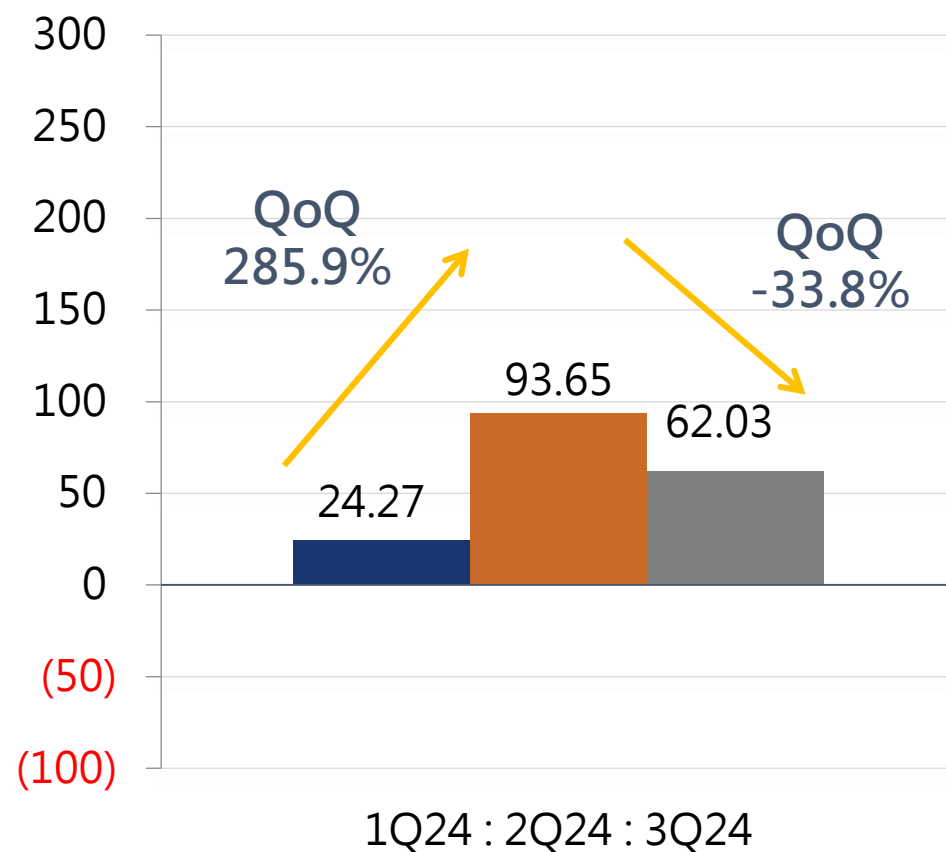
單位：新台幣佰萬元



合併營業利益(損失)



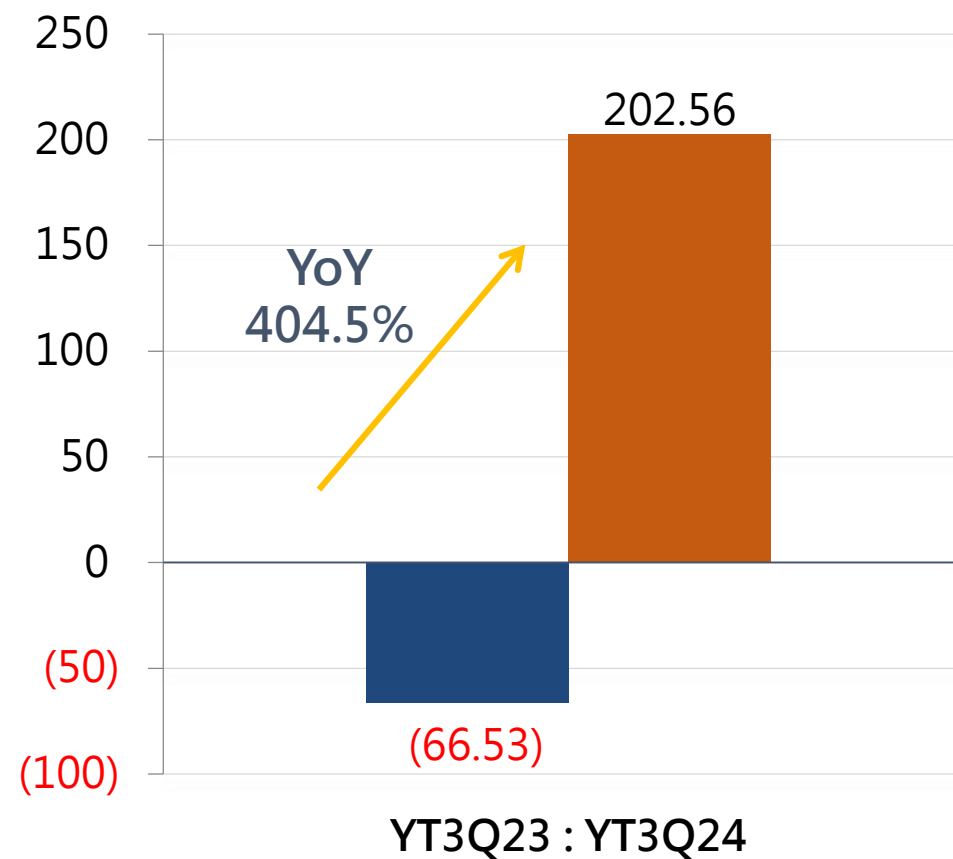
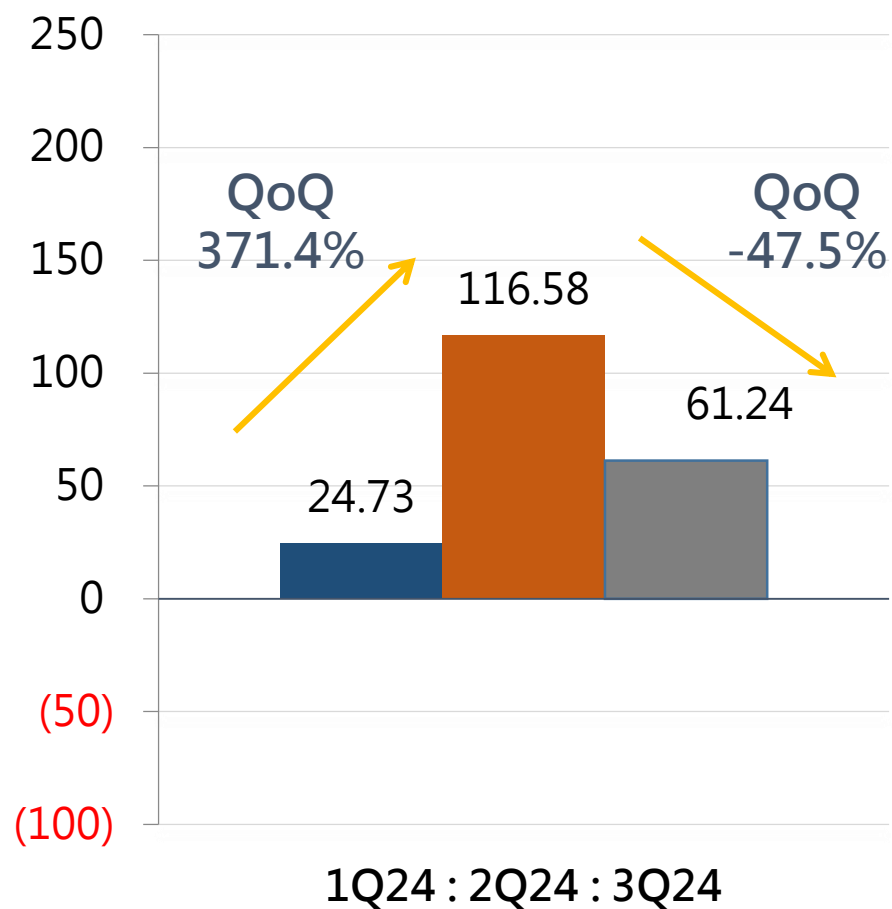
單位：新台幣佰萬元



合併本期淨利(損)



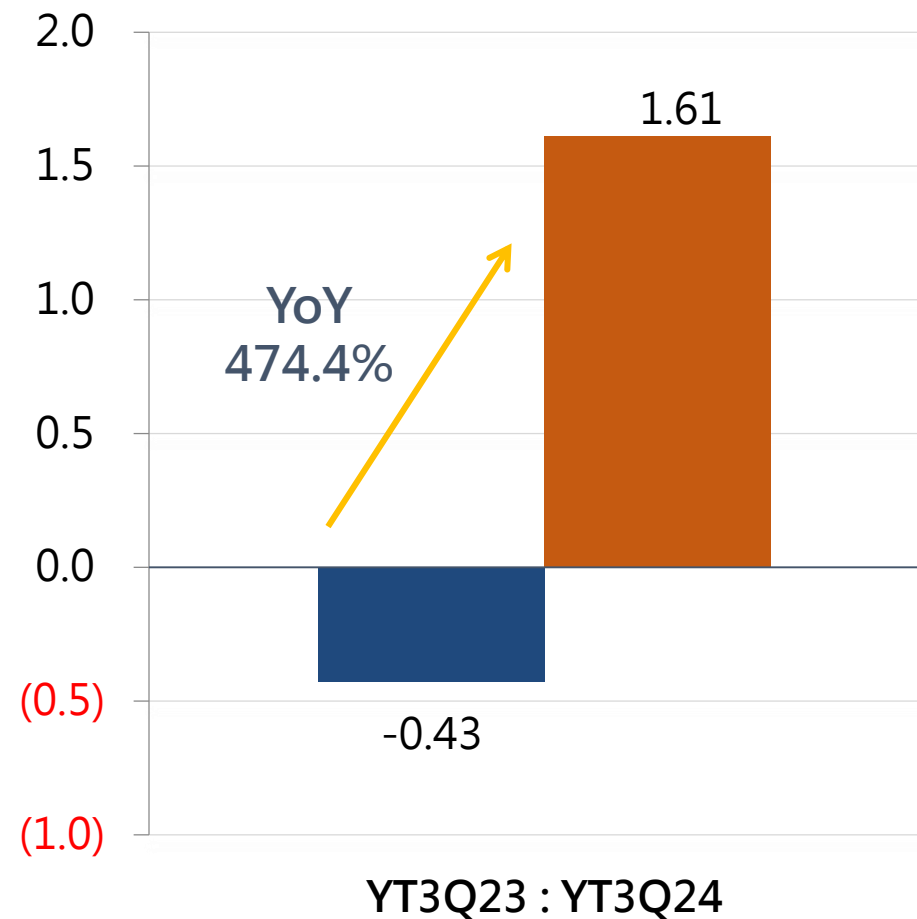
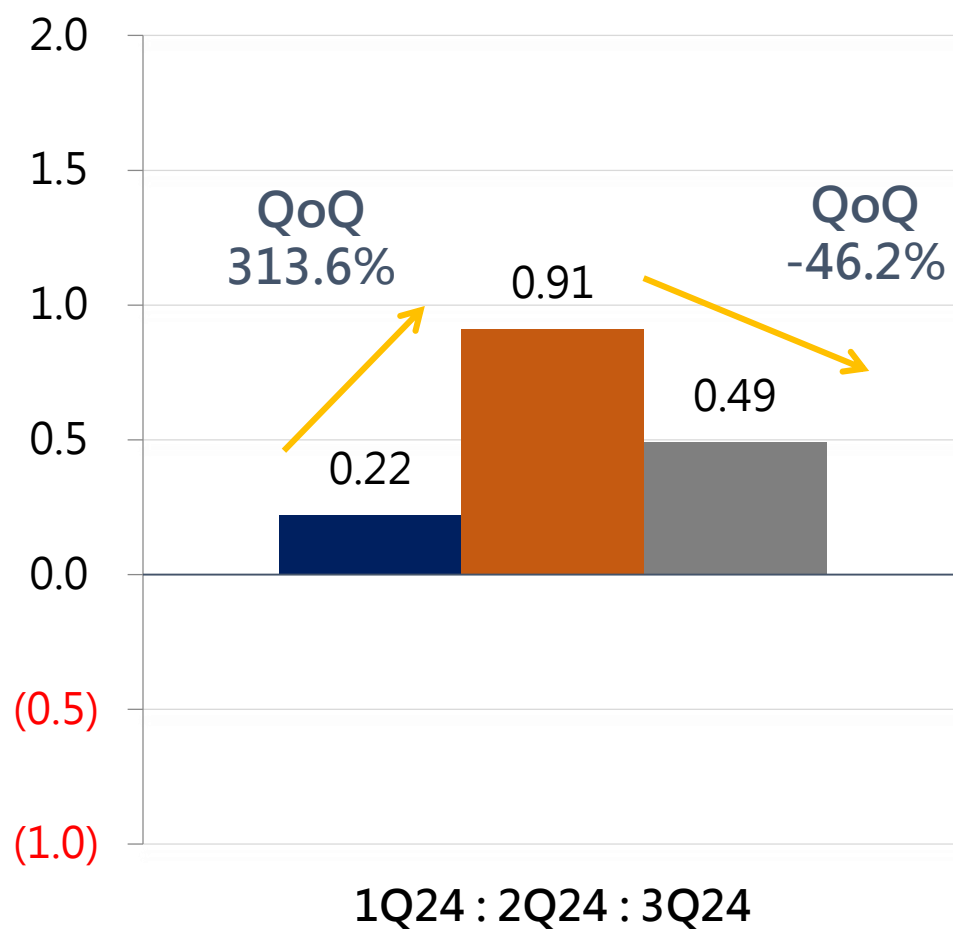
單位：新台幣佰萬元



每股盈餘



單位：新台幣元



資產負債表及重要財務指標



資產負債表項目	3Q24		2Q24		1Q24		3Q23	
單位：新台幣佰萬元	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	355.60	7.2%	342.17	6.9%	290.28	6.0%	326.35	6.5%
應收帳款	755.15	15.3%	696.53	14.1%	546.17	11.3%	531.11	10.6%
存貨	410.49	8.3%	421.50	8.5%	447.85	9.3%	510.24	10.2%
不動產、廠房及設備	3,124.33	63.3%	3,192.01	64.7%	3,261.47	67.7%	3,343.10	66.8%
其他資產	287.46	5.9%	278.66	5.8%	273.05	5.7%	292.54	5.9%
資產總計	4,933.03	100.0%	4,930.87	100.0%	4,818.82	100.0%	5,003.34	100.0%
流動負債	1,069.98	21.7%	1,001.09	20.3%	1,289.93	26.8%	1,257.92	25.1%
長期計息負債	741.53	15.0%	864.97	17.5%	538.68	11.2%	681.82	13.6%
其他負債	136.90	2.8%	142.56	2.9%	147.44	3.0%	157.66	3.2%
負債總計	1,948.41	39.5%	2,008.62	40.7%	1,976.05	41.0%	2,097.40	41.9%
權益總計	2,984.62	60.5%	2,922.25	59.3%	2,842.77	59.0%	2,905.94	58.1%
重要財務指標								
平均銷貨日數	101.35		102.60		105.59		155.82	
流動比率(倍)	1.50		1.54		1.05		1.15	
資產生產力(倍)	0.69		0.69		0.68		0.46	

*2024年第三季加權平均流通在外股數為132佰萬股

**資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

公司發展策略 & 布局未來

第一章

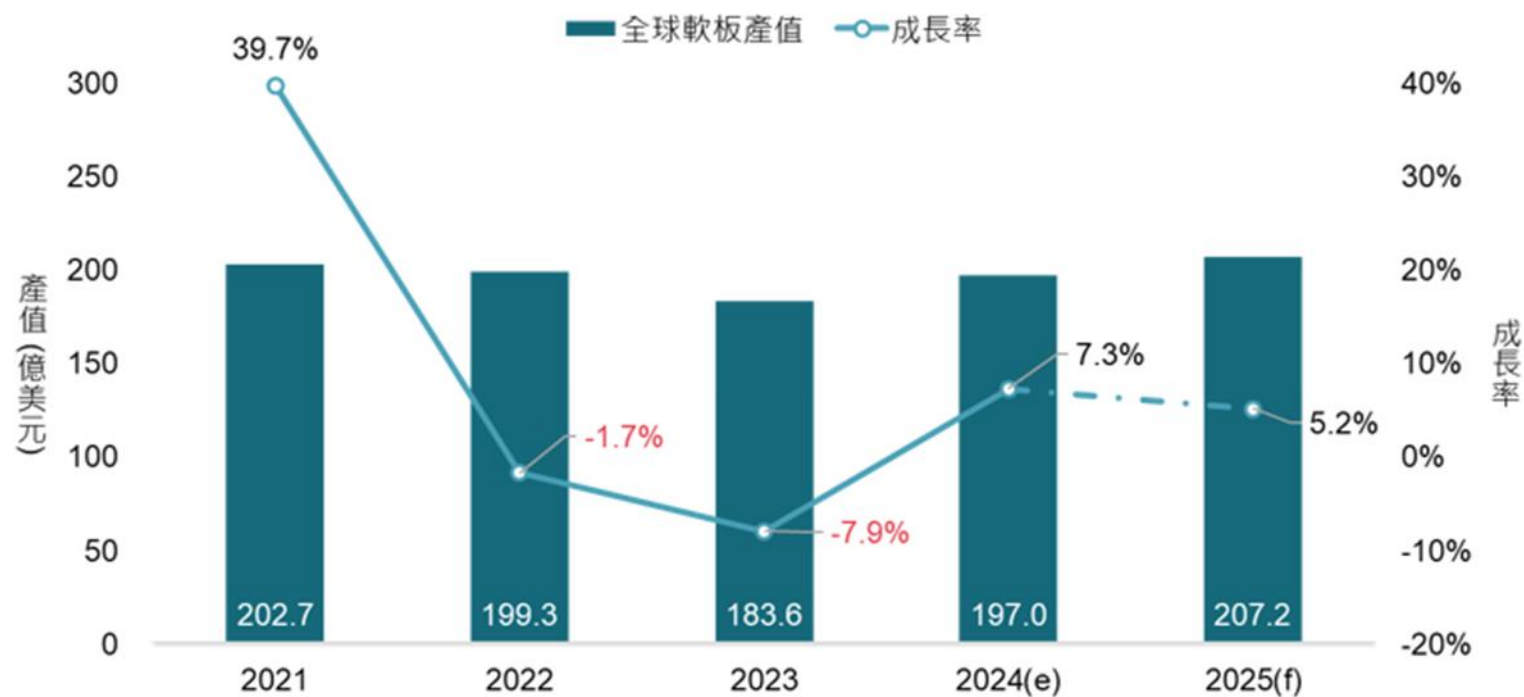
報告者:黃貞英總經理

ELECTRONICS SYSTEMS MARKET FORECAST

US\$mn	2023	2024F	YoY (%)	2028F	2023-28F CAGR (%)	Market share (%)	2023	2024F	2028F
Server/Data storage	8,201	9,781	19.3	14,221	11.6	Server/Data storage	12	13	16
Mobile phones	13,085	13,993	6.9	17,685	6.2	Mobile phones	19	19	20
Military/Aerospace	3,514	3,792	7.9	4,524	5.2	Military/Aerospace	5	5	5
Industrial	2,871	2,886	0.5	3,659	5.0	Industrial	4	4	4
Wired infrastructure	5,955	6,113	2.7	7,576	4.9	Wired infrastructure	9	8	8
Automotive	9,153	9,308	1.7	11,518	4.7	Automotive	13	13	13
Medical	1,440	1,512	5.0	1,771	4.2	Medical	2	2	2
Consumer	9,129	9,320	2.1	10,816	3.5	Consumer	13	13	12
PC	9,391	9,760	3.9	11,020	3.3	PC	14	13	12
Wireless Infrastructure	3,118	3,085	(1.1)	3,574	2.8	Wireless Infrastructure	4	4	4
Other computer	3,661	3,797	3.7	4,049	2.0	Other computer	5	5	4
Total	69,518	73,346	5.5	90,413	5.4	Total	100	100	100

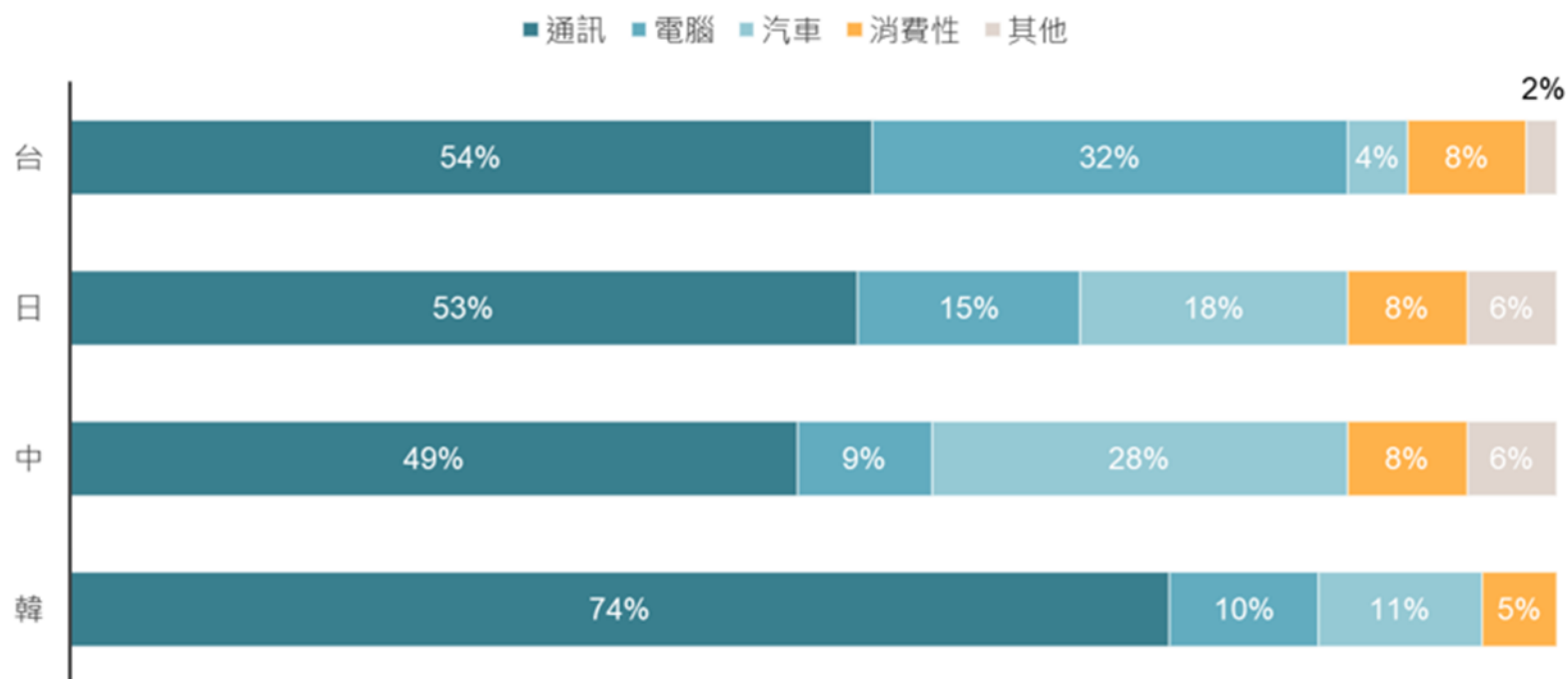
資料來源：Prismark；凱基

全球軟板市場趨勢



資料來源：TPCA & 工研院產科國際所

2023年全球軟板應用市場分布



資料來源：TPCA & 工研院產科國際所

2024年 整體經濟緩步成長

2025年 預判也是溫和成長的一年

✓更薄：第一階段任務如預期。

→持續展開下一階段的準備。

✓更厚：完成目前市場所需厚度的量產，並進入市場。

→接下來會更專注於特性提升。

✓更霧：在多種產品系列建立了更霧的生產能力及不同的製造工藝。

→展開認證工作。

公司發展策略 & 布局未來

第二章

報告者:吳聲昌董事長

未來的經營環境

- 多變的、不可預測的未來

- ① 地緣政治的瞬息萬變 (烏俄戰爭的持續、中東局勢的驟變、美中台經濟、國安、科技角力.....)
 - a. 貿易壁壘逐漸高築
 - b. 生產基地 2+1 布局規劃
- ② AI 人工智慧的深度進化、引領未來社會活動變化的不確定性

- 必須面對的全球暖化、氣候變遷議題

- ① 碳足跡的盤點、淨零碳排、碳中和、碳稅開徵帶來的企業經營衝擊

- 達邁思考的對應之道

用開放的心態，擴展各陣營、各產業合作，積極布局下一世代產業需求所需PI

讓客戶用了TMT的PI膜，有不可思議、幸福的感覺 → 朝 PI 膜的隱形冠軍努力

雙十展翼、再創新局 (第五講)

A. 兩支硬翅膀的 布局

- a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G
- b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

PFAS Free 危機就是轉機：從零開始的另外兩支硬翅膀
比的是速度 (研發實力、效率、產品信價比.....)

B. VCP 的發展 策略

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer , but also a Value Chain Provider (VCP)

歐洲PFAS綜合監管案

● 監管背景

PFAS 是根據其化學結構定義的**有機氟化合物**的總稱。

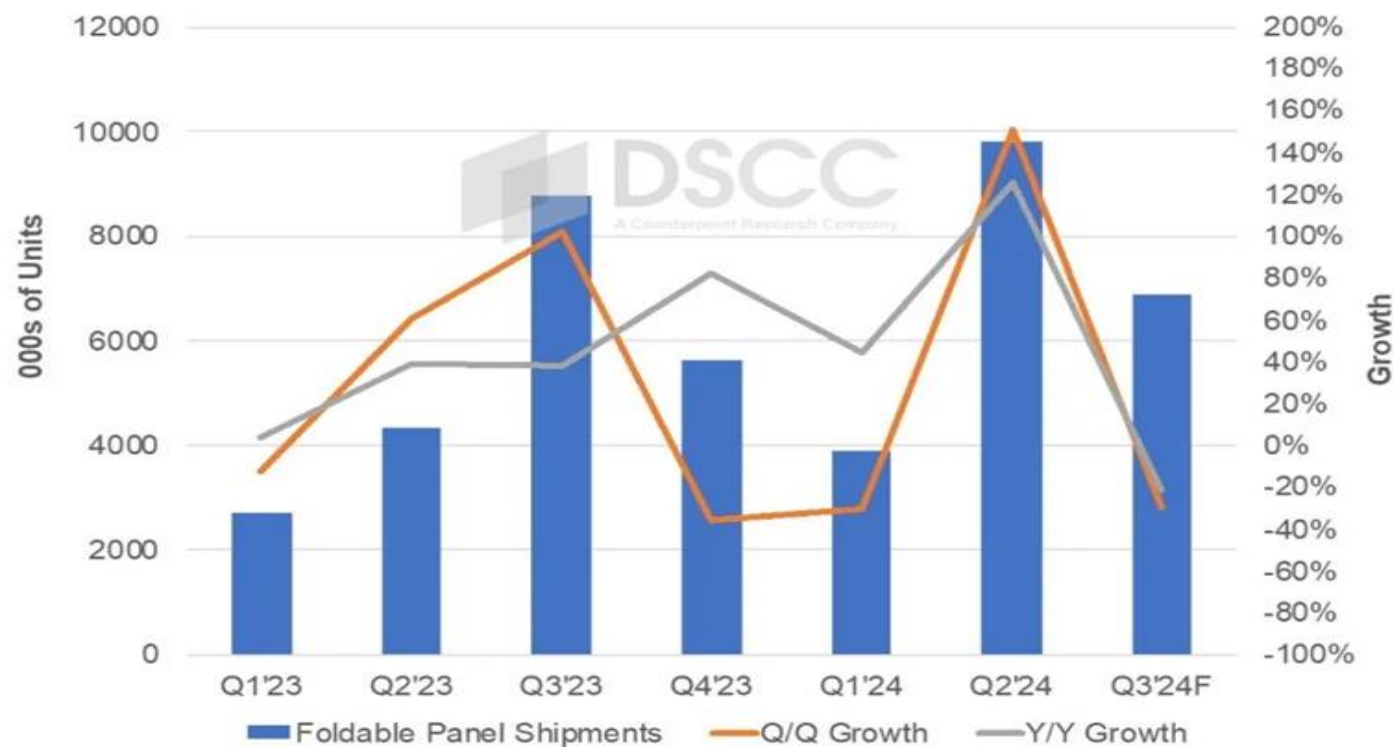
- 對象物質：(1)樹脂/橡膠、(2)氣體、(3)化學品（撥水撥油劑/精細化學品等）
- 不適用：④ 無機氟化合物，⑤ 部分氣體（R32、R23、TKN、R152a）

目前，(3) PFOS 和 PFOA (C8) 受到全球監管。自**2023年3月**起，類似物質**C9至C14**，基於長期殘留性，包括樹脂、橡膠、氣體在內幾乎對所有含氟有機物質已被追加到歐洲管制物質清單中。



2024年折疊手機面板出貨量- 2024/8/23

Quarterly Foldable Smartphone Panel Shipments and Growth



參考資料來源: <https://www.eettaiwan.com/20240823nt21-2024-q2-foldable-phone-panel-shipment/>

雙十展翼、再創新局 (第五講)

A. 兩支硬翅膀的 布局

- a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G
- b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

PFAS Free 危機就是轉機：從零開始的另外兩支硬翅膀
比的是速度 (研發實力、效率、產品信價比.....)

B. VCP 的發展 策略

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer , but also a Value Chain Provider (VCP)

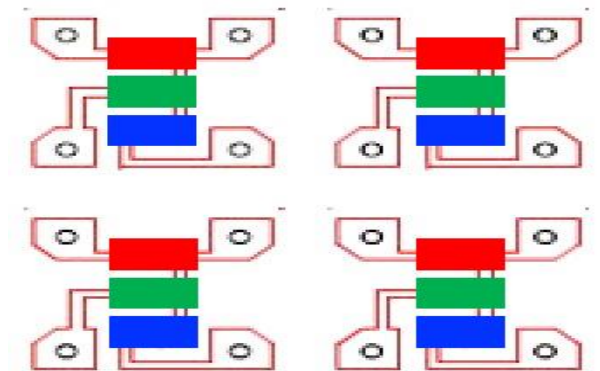
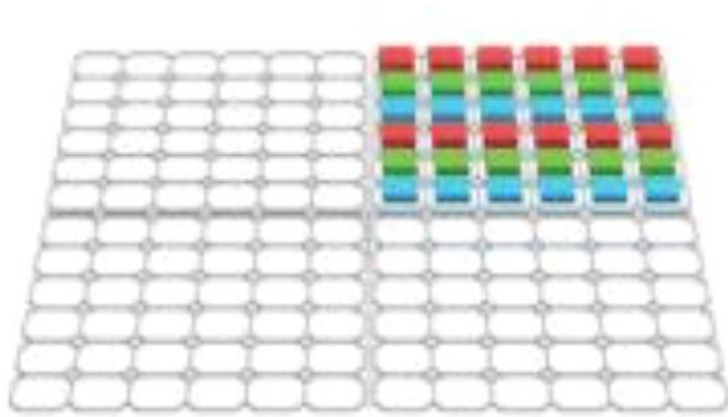
Value Chain Provider (VCP) amazing projects

- **μLED Display application**
- **Camera VCM Module**
- **AR Glasses**
- **Medical Instrument application**
- **IC Package**

μ LED Display application

- TMT ➡ 巨量轉移PI、BK線路**基材**

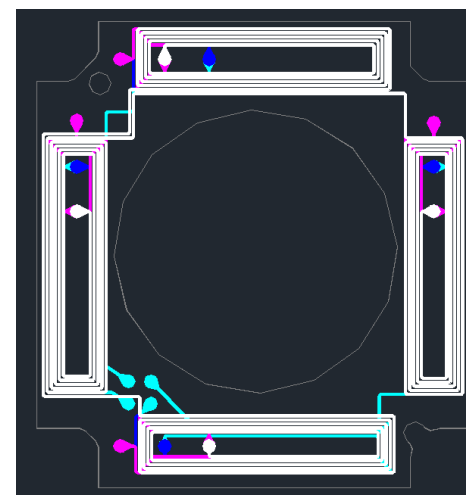
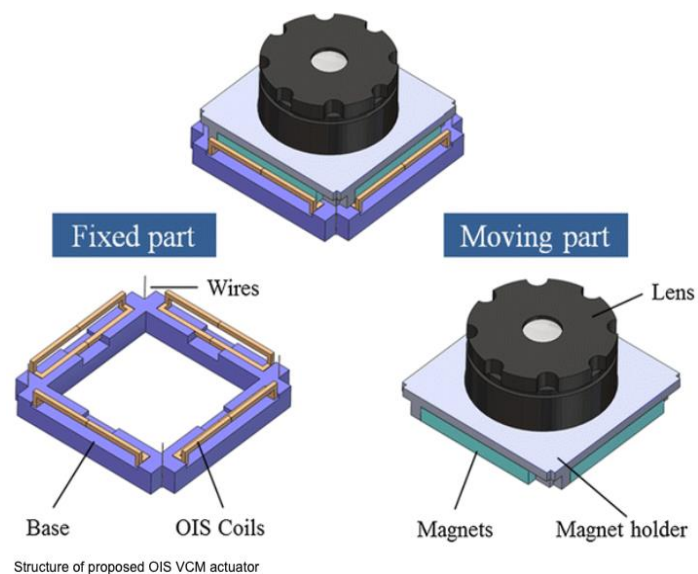
PMR ➡ 預鑽孔、**超細線路**、FOG 製程



Camera VCM

TMT ➡ 高剛性、高尺寸PI膜基材

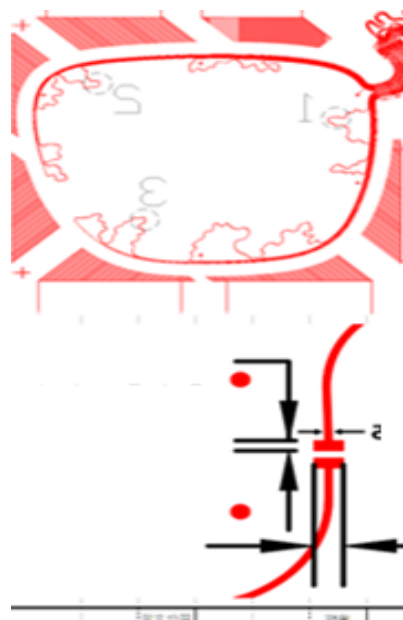
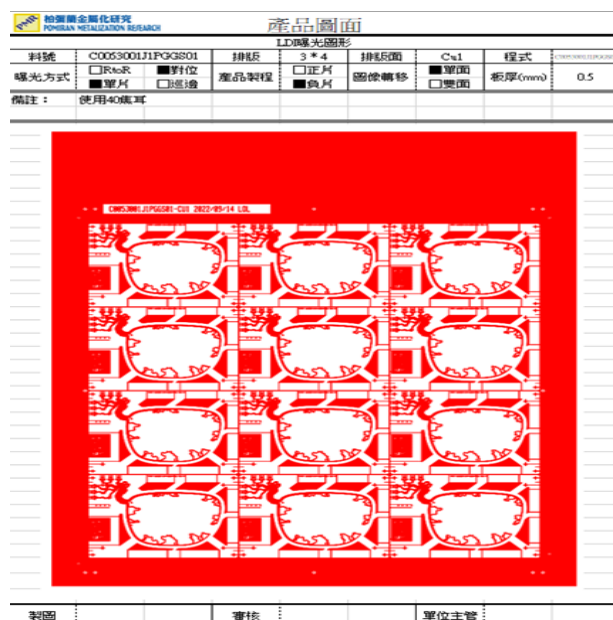
PMR ➡ 超微細線路、高深寬比($AR > 3$) Aspect Ratio 製程



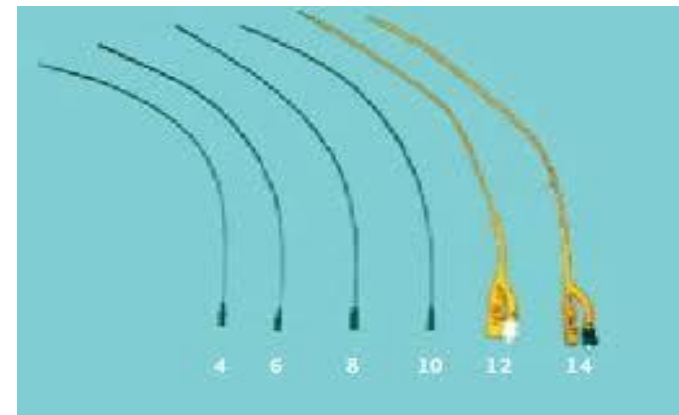
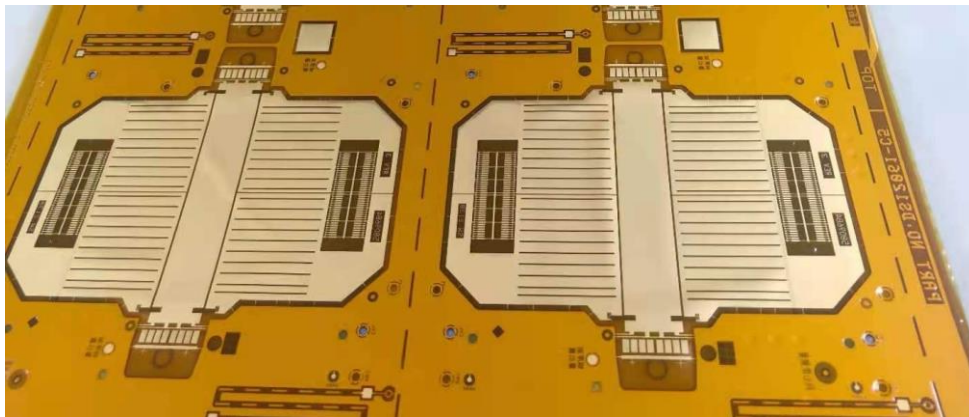
AR Glasses : Eye-Tracking Substrate

- TMT → OPI 透明、超薄基材、熱解黏膠

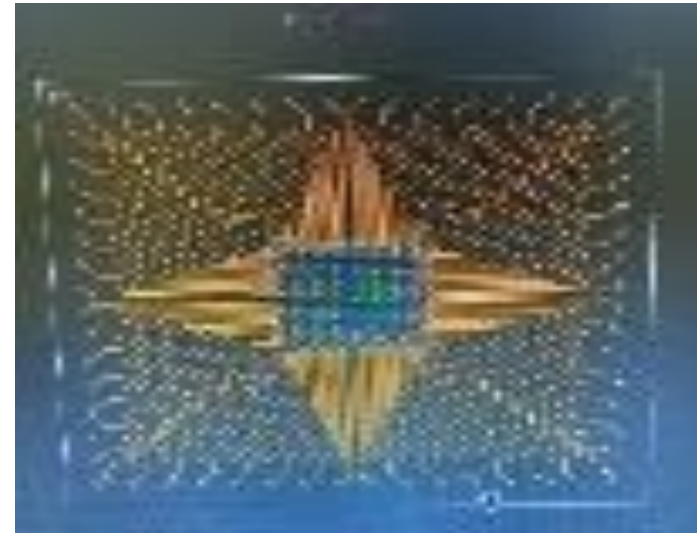
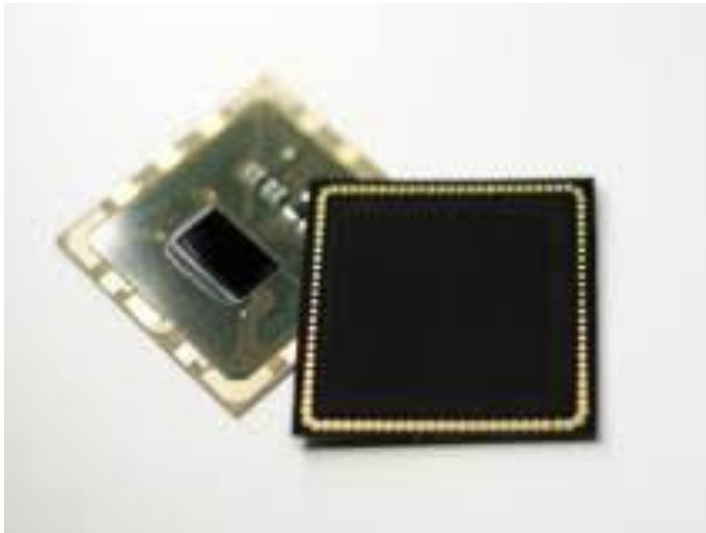
PMR → 超微細OPI線路、FOG 製程



Medical Instrument



IC Package



問題與交流



THE END